

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	淡水泉基金 叶智深 孝庸基金 李跃博 领丰资本 李健 腾飞资本 吴雪梅
时间	2026年2月25日 14:00-16:00
地点	北京经济技术开发区科创八街21号院 赛微电子北京MEMS产业基地五楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理、董事会秘书：张阿斌 证券事务部负责人：徐永文 证券投关高级经理：刘妍君
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司介绍 上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。赛微电子专注MEMS芯片制造主业，持续提升境内外产线的产能利用率及良率。公司看好万物互联与人工智能背景下智能传感芯片行业的未来发展空间，同时对自身的MEMS芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。 公司组织安排了北京FAB3产线洁净间参观活动。 第二部分：上市公司解答提问，主要如下：

1、请问公司收购青岛展诚科技有限公司的原因？

答：展诚科技是国家高新技术企业、国家专精特新“重点小巨人”企业、国家重点集成电路设计企业、山东省“瞪羚”企业。展诚科技主要从事芯片设计服务及 EDA 软件开发，服务于众多知名芯片设计企业，具备较强的客户及品牌基础，展诚科技在寄生参数提取领域具有多年研发经验，在中长期可有效协同配合公司在 MEMS EDA 领域的开发及对外服务工作，进一步增强公司在 MEMS 芯片制造领域的综合竞争力。

公司战略定位为半导体服务商，公司原有业务与展诚科技业务均是面向芯片设计公司提供专业服务，通过收购展诚科技，公司将进一步拓展和深化在 MEMS 芯片制造、芯片设计服务领域的战略布局，同时依托展诚科技在芯片设计服务及 EDA 软件开发领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，从而进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。

2、请问公司转让全资子公司瑞典 Sillex 控制权的原因？

答：公司在 2025 年上半年研判决策并快速执行瑞典 Sillex 控制权的出售，具有特定的国际政经环境背景考虑，是一项客观务实、多方平衡的举动，有助于为瑞典 Sillex 寻求更稳定的经营环境，使其能够有效应对国际政治环境变化带来的经营不确定性，能够促进其业务进一步增长，最大限度维护上市公司利益，避免潜在价值减损风险；同时，公司仍保留了瑞典 Sillex 约 45%股份，能够持续获取稳定投资收益，并保留了参与重大事项决策的权利。

因此，本次交易是公司当时在面临海外业务经营环境发生重大变化情形下作出的务实积极的应对方案，有利于最大程度维护上市公司及全体股东的利益。

3、请问公司瑞典产线与北京产线的毛利率有何区别？

答：瑞典产线运营了 25 年，产品及客户类别丰富，工艺开发业务占比较高，且由于折旧摊销压力较小，MEMS 业务的整体毛利率高于仍比较“年轻”的北京产线。虽然 MEMS 晶圆制造业务在当前阶段的毛利率较低，但北京产线 MEMS 工艺开发业务的毛利率却并不必然低于瑞典产线。MEMS 产线的工艺、运营状况及毛利率水平，本质上取决于市场订单需求。基于智能传感时代多点迸发的基础器件需求以及国产替代的时代背景，公司对北京产线业务在中长期的毛利率水平持有信心。

4、北京 MEMS 产线的产能利用率仍处于较低水平，公司对此有何规划？

答：与 IC 产线的标准化流程不同，MEMS 产线涉及晶圆类别众多、工艺及材料纷繁复杂。公司北京 FAB3 产线当前的主要工作在于，积极推动硅麦克风、BAW 滤波器、MEMS 微振镜、MEMS 高频器件等产品的量产爬坡，以及 MEMS 气体、生物芯片、加速度计、惯性 IMU、温湿度、MEMS-OCS、硅晶振等产品的风险试产；同时陆续推动微流控、压力、磁性传感、3D 硅电容等 MEMS 芯片、器件及模块的工艺开发；未来随着客户及订单需求的持续增加，公司需要更加重视工艺及良率提升，特别关注保障产能爬坡过程中的一致性 & 稳定性，推动产能利用率的持续提升。

另外，由于 MEMS 行业高度定制化、验证试产之后才有量产的客观规律，MEMS 产线将根据晶圆系列规划陆续有针对性地扩充产能，产能利用率也一般低于 CMOS 产线，同时在一定时期往往存在“产能等待订单”的状态。公司客观看待北京 MEMS 产线所处发展阶段，既理解短期较低的产能利用率水平，又对中长期产能利用率的持续提高充满信心。

5、请问贵公司北京 FAB3 未来的产品规划是怎样的？

答：北京 FAB3 已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、硅晶振、MEMS-OCS 等 MEMS 器件，同时对于微流控、压力、磁性传感、3D 硅电容等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。北京 FAB3 将继续做好中长期规划，密切关注市场环境动态，深化全国重点区域布局，注重分析产品在不同应用领域的特点，持续提升运营能力。

6、近年来 MEMS 行业的整体增速并不高，请问公司如何看待 MEMS 行业未来的市场规模？

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代。我们认为，基于“软硬件一体配比”的逻辑，相较于 IC 芯片产业的规模体量，MEMS 芯片产业仍处于发展初期，体量仍小，未来发展前景广阔。

7、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？

答：在我们看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的业务情况确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时我们也应看到，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线

向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投资，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。

综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。

8、请问 MEMS 行业当前的发展情况及竞争格局如何？

答：随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件逐步被替代，MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）达到 3.7%。

MEMS 行业 Foundry 模式与 IDM 模式并存，代工企业通过支持 Fabless、Fablite 设计公司快速创新，推动 MEMS 生态发展。公司非常突出的特点在于，公司是国内业界领先、极少数以 Pure-Foundry 模式运营的 MEMS 芯片专业制造厂商，包括其他商业模式下的竞争对手主要为台积电、Teledyne、IMT、X-FAB、芯联集成、华鑫微纳、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微等。

截至目前，不同 MEMS 应用领域的竞争格局存在不同差异，通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子领域的中高端市场已经开始出现国产替代，未来具有广泛发展空间。

	<p>总体来看，MEMS 行业正处于关键发展期，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素，公司在 MEMS 产业链中拥有清晰的角色定位及充分的发展定力。</p> <p>9、请问控股股东部分股份司法冻结的最新进展如何？</p> <p>答：2026 年 1 月 27 日，山东省青岛市中级人民法院组织案件当事人进行了证据交换，暂未进行实质性审理；具体审理时间待法院进一步通知，公司也将及时披露相关进展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 2 月 25 日